

エレファンテック、豊洲アドバンスドパッケージングセンターを開設

- AI サーバ向け基板・先端パッケージへの量産適用を加速 -



エレファンテックの新拠点 豊洲アドバンスドパッケージングセンター



開設準備が進む豊洲アドバンスドパッケージングセンター

エレファンテック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：清水 信哉）は、新拠点として、豊洲アドバンスドパッケージングセンター（以下、豊洲 APC）を 2027 年 3 月に開設します。豊洲 APC では、拡大する AI サーバ需要に対応するためのスケールアップ設備と先端パッケージ開発環境を構築します。それに合わせて、材料、装置、プロセスなど幅広い領域で積極的に採用を行います。

エレファンテックは、独自の銅ナノ材料技術と精密インクジェット技術を用いて、基板をより高密度・低環境負荷で製造できるプロセスを開発しています。特に AI サーバにおいて、基板は AI 計算能力のボトルネックとなっており、高速伝送、高密度配線、大電力伝送の両立が求められています。エレファンテックの DeepVia™ HDI

は、より高アスペクト比のビアを実現することで基板のデザインルールを変え、基板の設計自由度を高めることで AI サーバ性能向上に貢献します。既に北米大手 AI 半導体メーカーの次世代 AI サーバ基板向けに、装置出荷がスタートしています。

https://elephantech.com/news/press_release_20260918/

さらに、既に発表した半導体パッケージ基板・次世代先端パッケージ向け技術 DS-SAP™も、北米大手 AI 半導体メーカーと AI サーバ向け量産適用に向けた協議・デザイン検討を進めております。

https://elephantech.com/news/press_release_20260618/

それらの非常に強い AI サーバ向け需要に応えるため、豊洲 APC をオープンします。豊洲 APC は、東京都江東区に位置し、延床面積約 6,700 m²の建物に、スケールアップ設備とクリーンルームを含む先端パッケージ開発環境を整備する拠点です。最大 550 × 622 mm のパネルを対象とした印刷から銅めっきまでの試作設備を整備し、先端パッケージ・先端 PCB の試作・開発を行います。さらに分析装置として AFM-IR、SEM、XRD、蛍光 X 線などを設置し、評価・分析まで一貫して行うことで、量産適用に向けた開発を加速します。

代表取締役社長 清水信哉 コメント

「豊洲 APC の開設を発表できることを嬉しく思います。弊社のナノ材料技術は現在、AI 計算の性能を向上させる新技術として注目されており、ほとんど全ての主要 AI 半導体メーカーと設計検討を行っております。その強い要求に応じていくために、試作・開発から評価まで一貫して行える拠点は必須であると考えておりました。またそのためには、人材採用が最も重要であるため、働きやすい都心で一定の広さを持つ拠点を確保したいと考えており、そのために最適な拠点として豊洲 APC を開設する運びとなりました。ここを拠点に、材料・製造装置メーカーとして、グローバルに展開して参ります」

施設概要

名称	豊洲アドバンスドパッケージングセンター（豊洲 APC）
所在地	135-0051 東京都江東区枝川 2 丁目 24-12
開設予定	2027 年 3 月
建物延床面積	約 6,700 m ²
主な機能	AI サーバ向け基板・先端パッケージの材料・プロセス開発、試作、評価・分析

会社概要

会社名	エレファンテック株式会社
設立	2014 年 1 月
本社所在地	104-0032 東京都中央区八丁堀四丁目 3 番 8 号
代表	代表取締役社長 清水 信哉
事業内容	先端半導体パッケージング向け装置およびナノ材料の開発・製造・販売
URL	https://elephantech.com/